

## 贵州振华风光半导体股份有限公司

### 关于核心技术人员离职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要风险提示：

- 贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员夏良先生近日因个人原因申请辞去公司相关职务，并已办理完成工作交接及离职手续。辞职后夏良先生将不在公司担任任何职务。
- 夏良先生任职期间参与申请的专利等知识产权均为职务成果，截至本公告披露日，其在职务成果所形成的知识产权所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司知识产权的完整性。
- 夏良先生离职不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

#### 一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员夏良先生近日因个人原因申请辞去公司相关职务，并已办理完成工作交接及离职手续，辞职后夏良先生将不在公司担任任何职务。公司及董事会对夏良先生在任期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

##### （一）基本情况

夏良先生，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，总经理助理，封装方向负责人。2007年3月至2014年6月，在三星苏州

公司工程部PKG担任技术经理；2014年6月至2019年6月，在三星西安分公司PKG技术部担任高级工程经理；2019年7月至2020年4月，在北京紫光存储科技有限公司担任封装开发部门总监；2020年5月至2020年10月，担任公司副总工程师，封装专业技术负责人；2020年11月至今担任公司总经理助理、封装方向负责人。

### （二）夏良先生参与的项目及知识产权情况

夏良先生任职期间参与了公司相关研发工作，期间参与申请的专利等知识产权均为职务成果，截至本公告披露日，其在职务成果所形成的知识产权所有权均归属于公司，不存在涉及职务成果、知识产权的纠纷或潜在纠纷，其离职不影响公司知识产权的完整性。夏良先生目前已经完成工作交接，其离职不会对公司的技术研发和日常经营造成重大不利影响。

### （三）保密与竞业禁止情况

根据公司与夏良先生签署的《劳动合同》《员工知识产权与保密协议》《离职人员保密承诺书》，双方对保密内容以及权利义务、违约责任进行了明确的约定。夏良先生对其在公司工作过程中所获得所有保密和专有信息负有保密义务。截至本公告披露日，未发现夏良先生有违反保密义务的情形。

## 二、核心技术人员离职对公司的影响

公司自设立以来高度重视研发工作，已建立了较为科学的研发体系，研发团队结构完整，具备良好的人才梯队基础，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司核心技术及创新产品的持续开发，不存在对特定核心技术人员的重大依赖。公司2023年末、2024年末和2025年末，公司研发人员的数量分别为241人、250人、264人，占总员工人数的比例分别为28.76%、29.07%、30.88%。

截至本公告披露日，公司核心技术人员共 5 人，具体如下：

时间	核心技术人员姓名
----	----------

本次调整前	胡锐、夏良、唐毓尚、李平、李雪、李政
本次调整后	胡锐、唐毓尚、李平、李雪、李政

目前，公司的技术研发和日常经营均正常进行，本次核心技术人员的调整不会对公司技术研发、核心竞争力和持续经营能力产生实质性影响。

### 三、公司采取的措施

公司研发团队结构完整，后备人员充足，现有核心技术人员及研发团队能够支撑公司未来核心技术的持续发展，目前公司各项研发活动均处于正常有序的推进状态。未来公司将进一步加大研发技术人员的培养和引进，不断提升公司技术创新能力。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2026年6月18日